

底部填充剂 FF35

特性

- ▶ 快速流动性
- ▶ 可返修
- ▶ 兼容免洗助焊剂残留物
- ▶ 极少的空洞
- ▶ 良好的储存性能
- ▶ 符合 RoHS

描述

FF35 是一个低表面张力、单组份环氧树脂的填充剂，用于倒装芯片、CSP、BGA 和 uBGA 毛细填充组装。FF35 提供了良好毛细作用形成了一层薄的熔合线以及完整的扩散。FF35 通过高 T_g，低 CTE 和优异的附着以增强可靠性。快速流动性、快速的固化性能保证了更快的产通率和更高的产量。FF35 可以在 120°C (250°F) 进行返修。FF35 的粘度和性能始终保持稳定的保质期，方便使用。

物理特性

参数	结果
外观	淡黄色
比重	1.08 G/cc 典型值
潮湿率	0.02% 典型值
总挥发物	< 1% 典型值
粘度 at 25°C (77°F) at 5 RPM	500 cps 典型值
毛细流动速率测试	5 mm/1 minute* 典型值
TG	55°C 典型值
离子含量	< 10 ppm 典型值
T _G , °C	55 典型值
CTE, $\mu\text{m}/(\text{m}^\circ\text{C})$ Before T _G	47 典型值
CTE, $\mu\text{m}/(\text{m}^\circ\text{C})$ After T _G	165 典型值

处理 & 储存

参数	时间	温度
冷冻保质期	6 个月	< 0°C (32°F)
冷藏保质期	1 个月	0°C-12°C (32°F-54°F)
非冷藏保质期	1 周	< 25°C (77°F)

不要靠近火源或易燃物。避免光照，以免降低产品质量。

应用

为了得到更好的结果,应用基体工件应预热到 40 - 50°C (100°-120°F)。尽管不是必需的,可以通过预热喷嘴来降低黏度或增加流速。系统的压力应在 1 至 2.75 巴(15 到 40 磅每平方英寸)。喷涂速度也应在 0.25 至 1.25 厘米/秒。此外,喷涂平台应该能够维持针尖离基体大约 0.025 - 0.075mm (1-3 mils) 的距离偏量和 0.025-0.075mm (1-3 mils) 芯片边缘偏移量。这将最大程度地确保填充剂的流动一致性。喷涂模的模口最小应用为 0.65mm (1/4"), 是典型的单边或单角, 无二次喷涂或最终周边需求。这个产品低粘度和良好的润湿特性允许自动填充芯片的另一边。返修: 温度 120°C-140°C (250°F-280°F) 时流动。

参数	结果
固化时间 at 100°C (210°F)	8-10 分钟
固化时间 at 125°C (260°F)	4-5 分钟
固化时间 at 150°C (300°F)	1-2 分钟

*最高固化温度 150°C (300°F).

安全

保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况, 请参照 SDS 信息。不要在未核准容器内处理任何有害物质。